



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D210379 S

(45)公告日：中華民國 110 (2021) 年 03 月 11 日

(21)申請案號：109302067

(22)申請日：中華民國 109 (2020) 年 04 月 16 日

(51)LOC.(11)Cl.：15-99

(30)優先權：2019/10/18 日本

2019-023330

(71)申請人：日商日立全球先端科技股份有限公司(日本)HITACHI HIGH-TECH CORPORATION
(JP)

日本

(72)設計人：中谷信太郎 NAKATANI, SHINTAROU (JP)

(74)代理人：林志剛

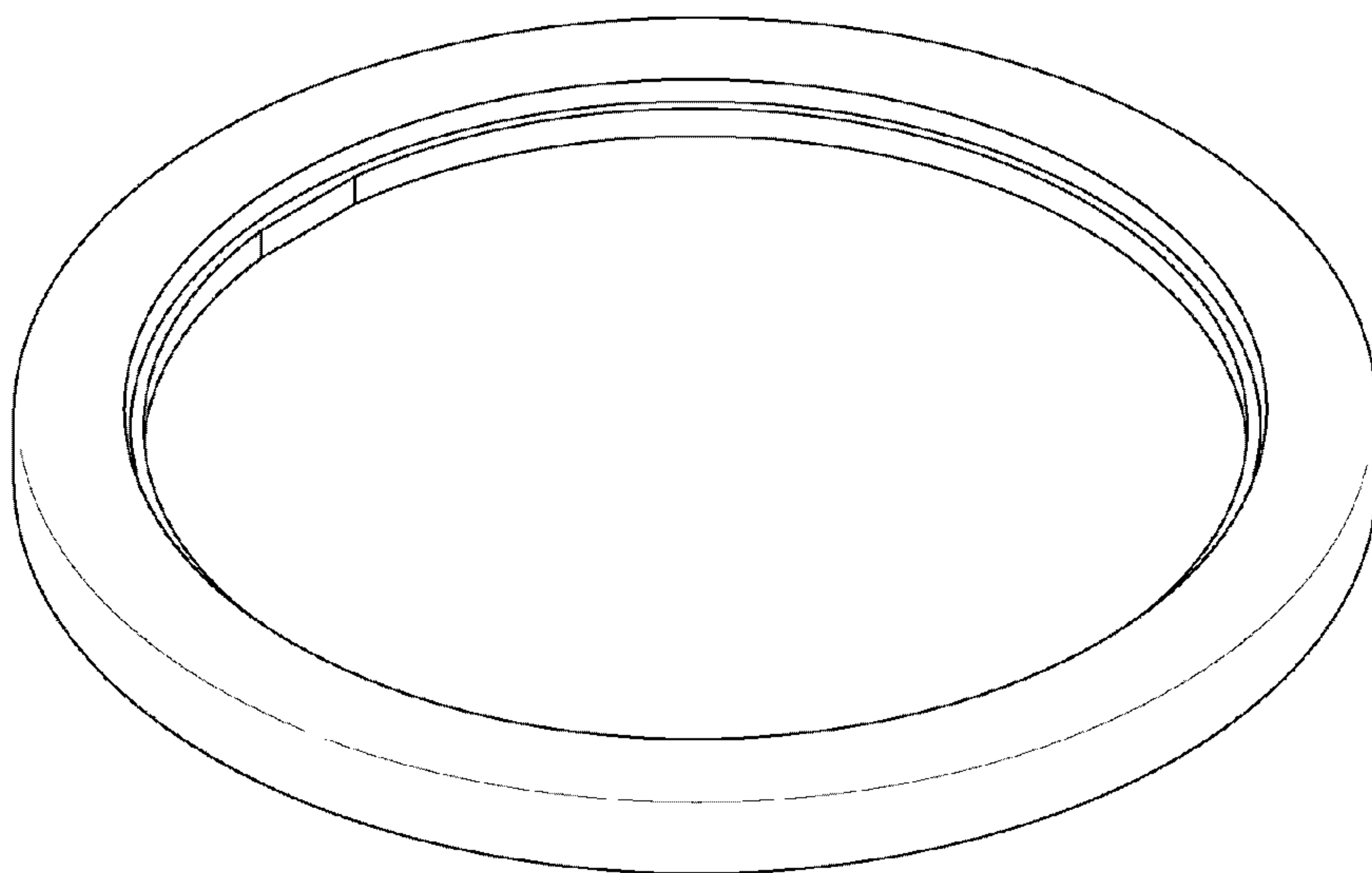
審查人員：張玉玫

圖式數：13 共 8 頁

(54)名稱

電漿處理裝置用保護環

代表圖：



【立體圖 1】



D210379

【設計說明書】公告本

【中文設計名稱】電漿處理裝置用保護環

【物品用途】

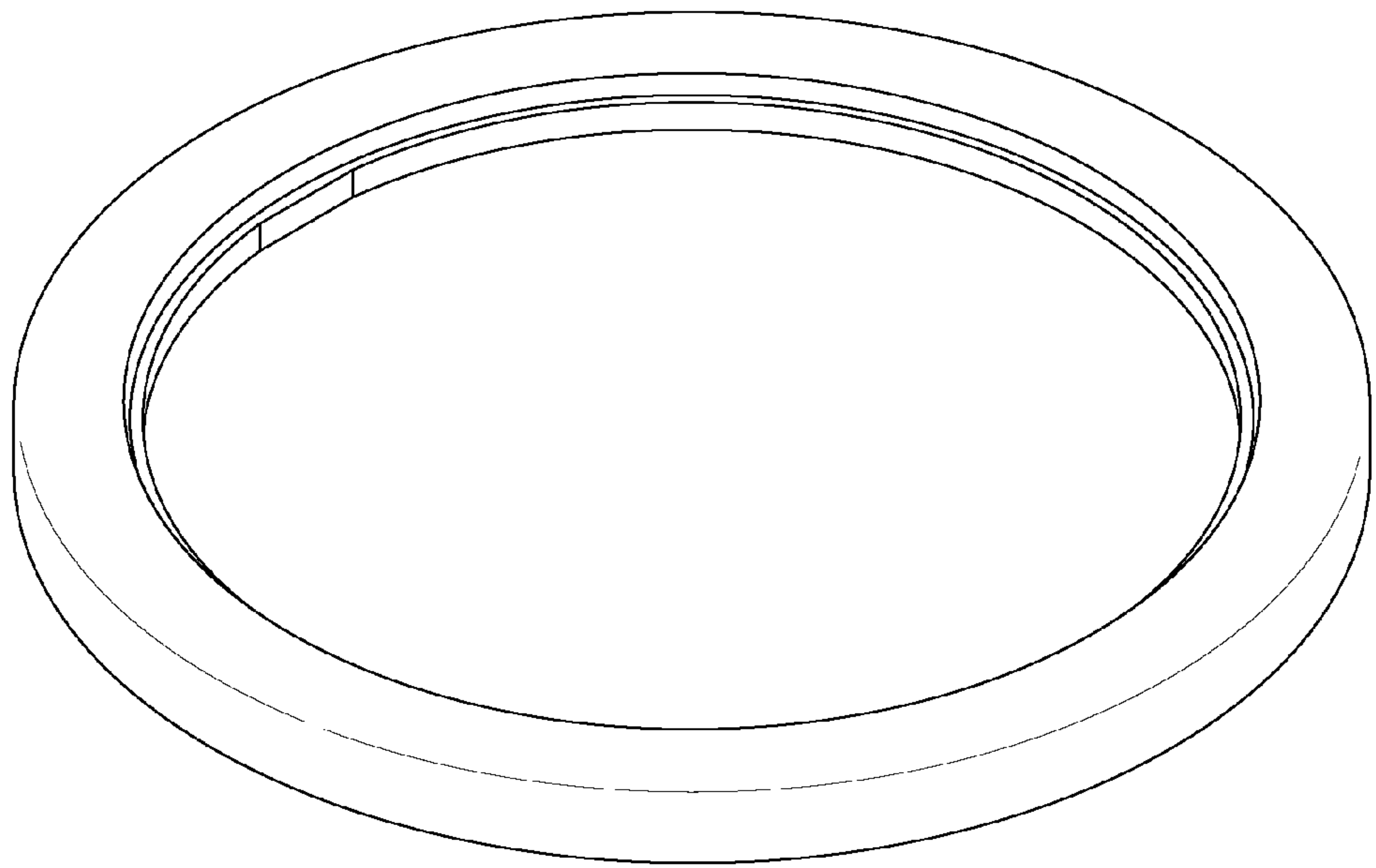
【0001】本設計的物品是電漿處理裝置用保護環，為一種在製造半導體時所使用的電漿處理裝置中用來保護靜電吸盤及RF供電環不會受到電漿破壞的保護環。

【設計說明】

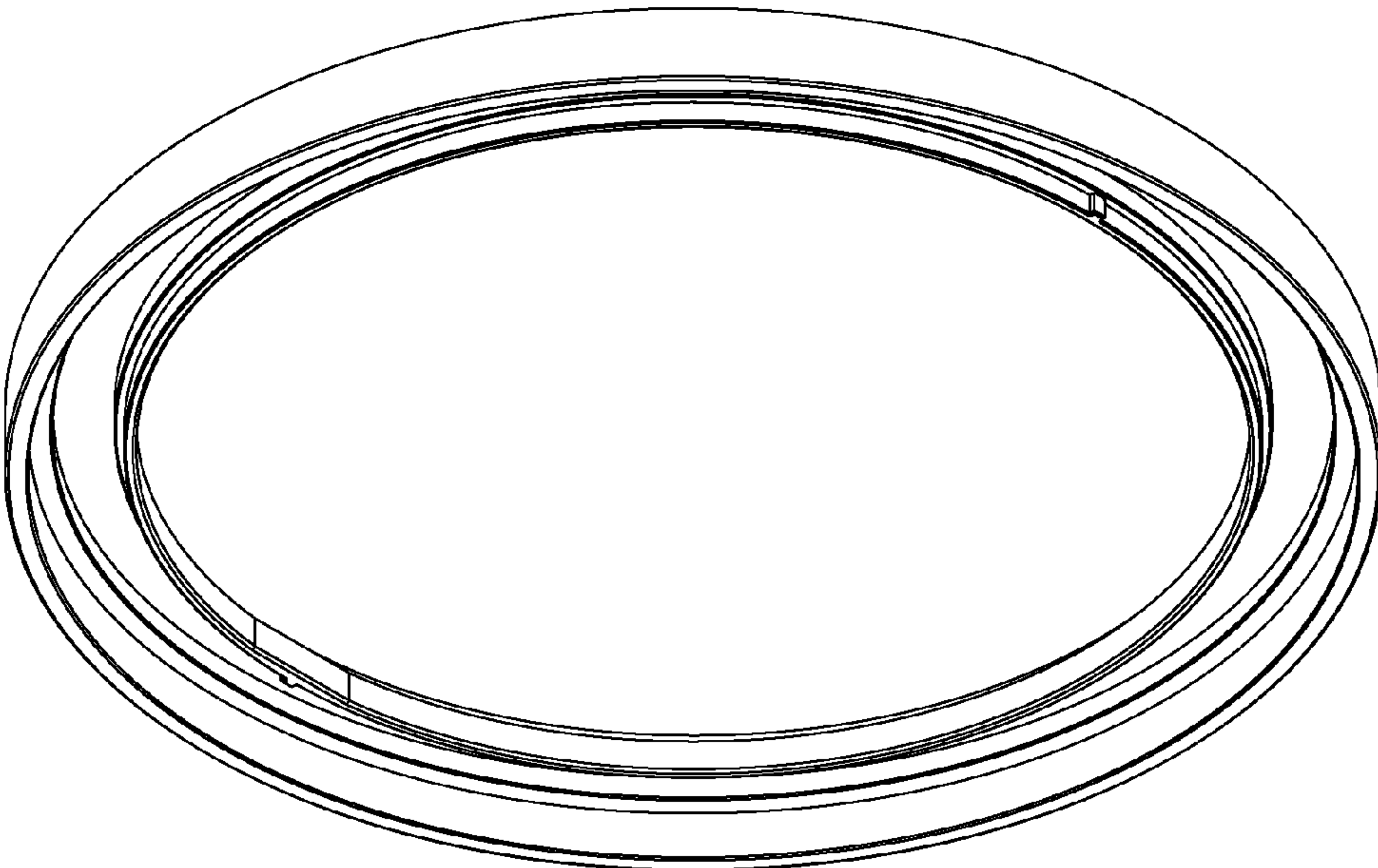
【0002】本物品係如「B-B部分放大圖」所示，係具備略呈橫長矩形狀的大溝槽，並且具備較長的外周緣部，因此係如「使用狀態及標示各部名稱之參考圖」的例子所示，於使用狀態中，本物品的外周緣部是成為圍繞位於其內側之構造物的形狀。

【0003】各立體圖中，未呈現在其他六面圖的細線，皆為用來表現立體表面之形狀的線條。

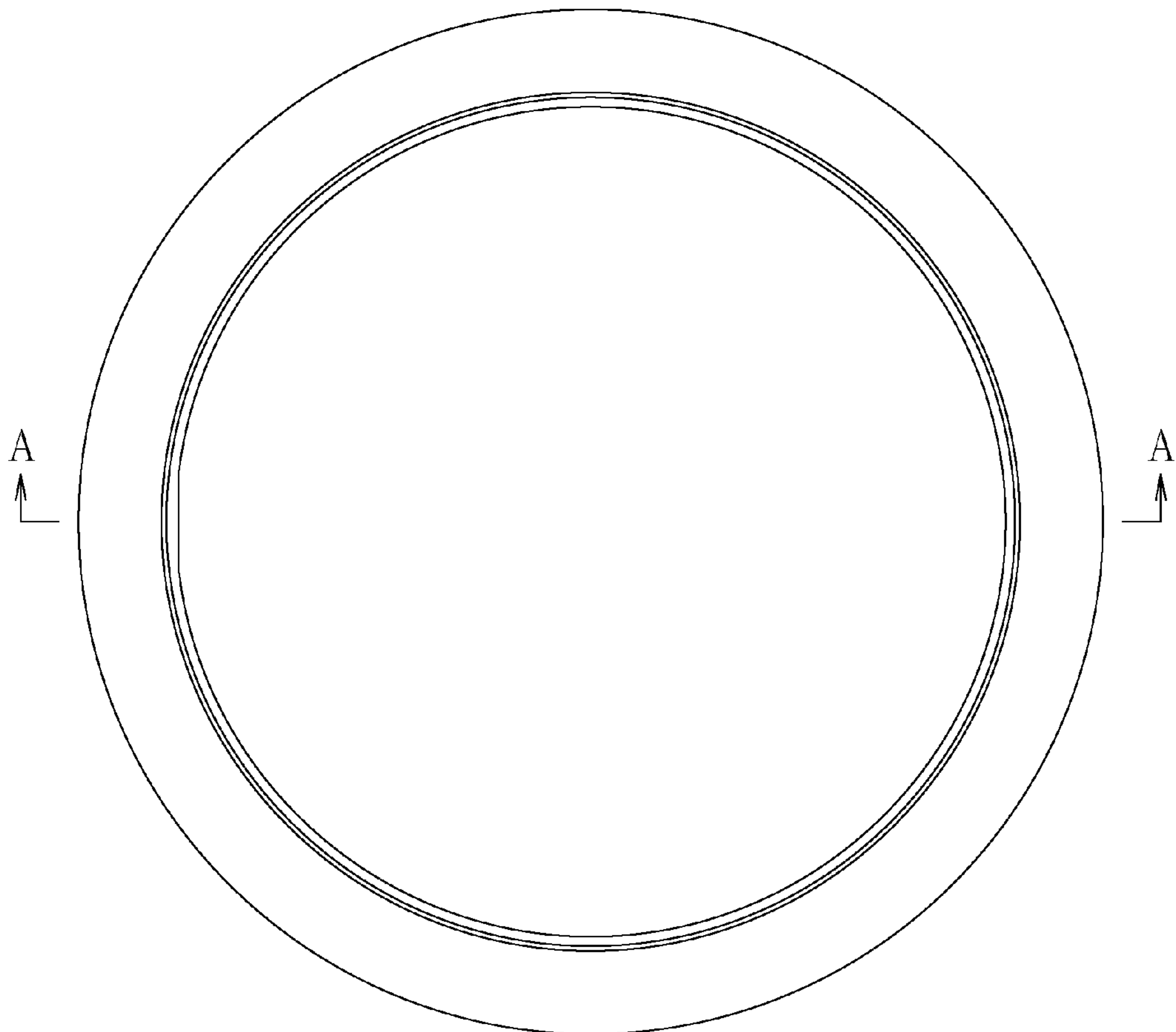
【設計圖式】
(指定代表圖)



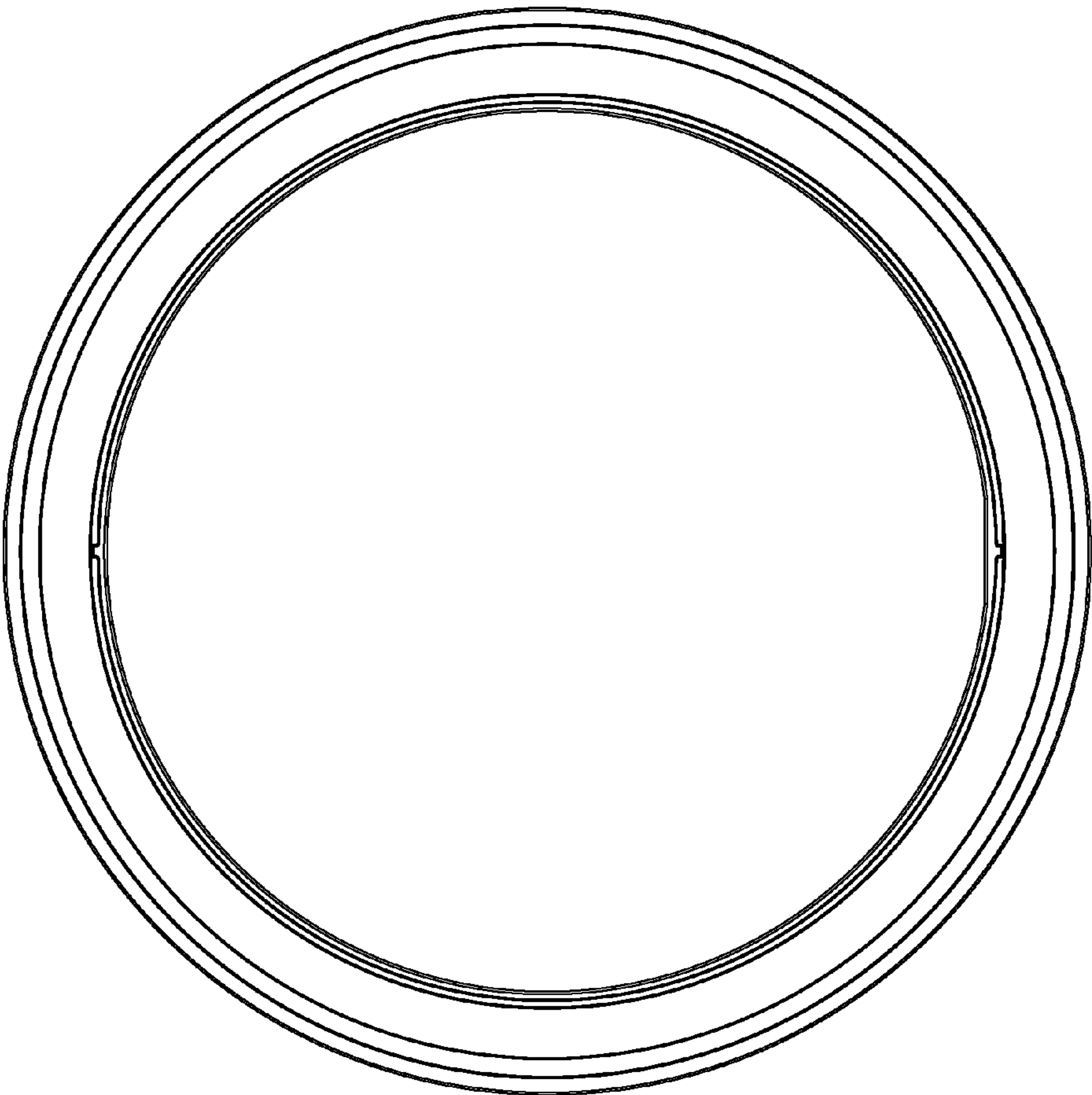
【立體圖 1】



【立體圖 2】



【前視圖】



【後視圖】

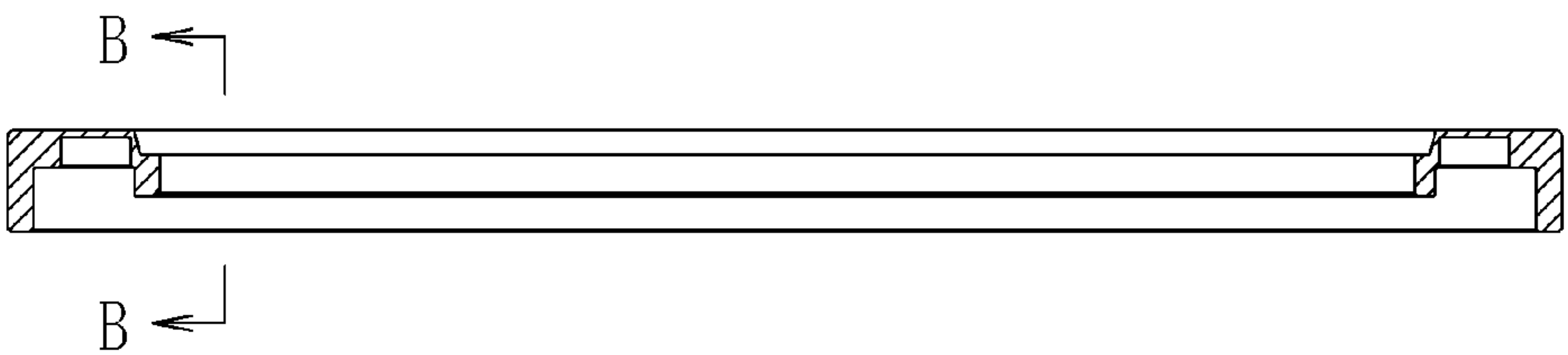


【俯視圖】

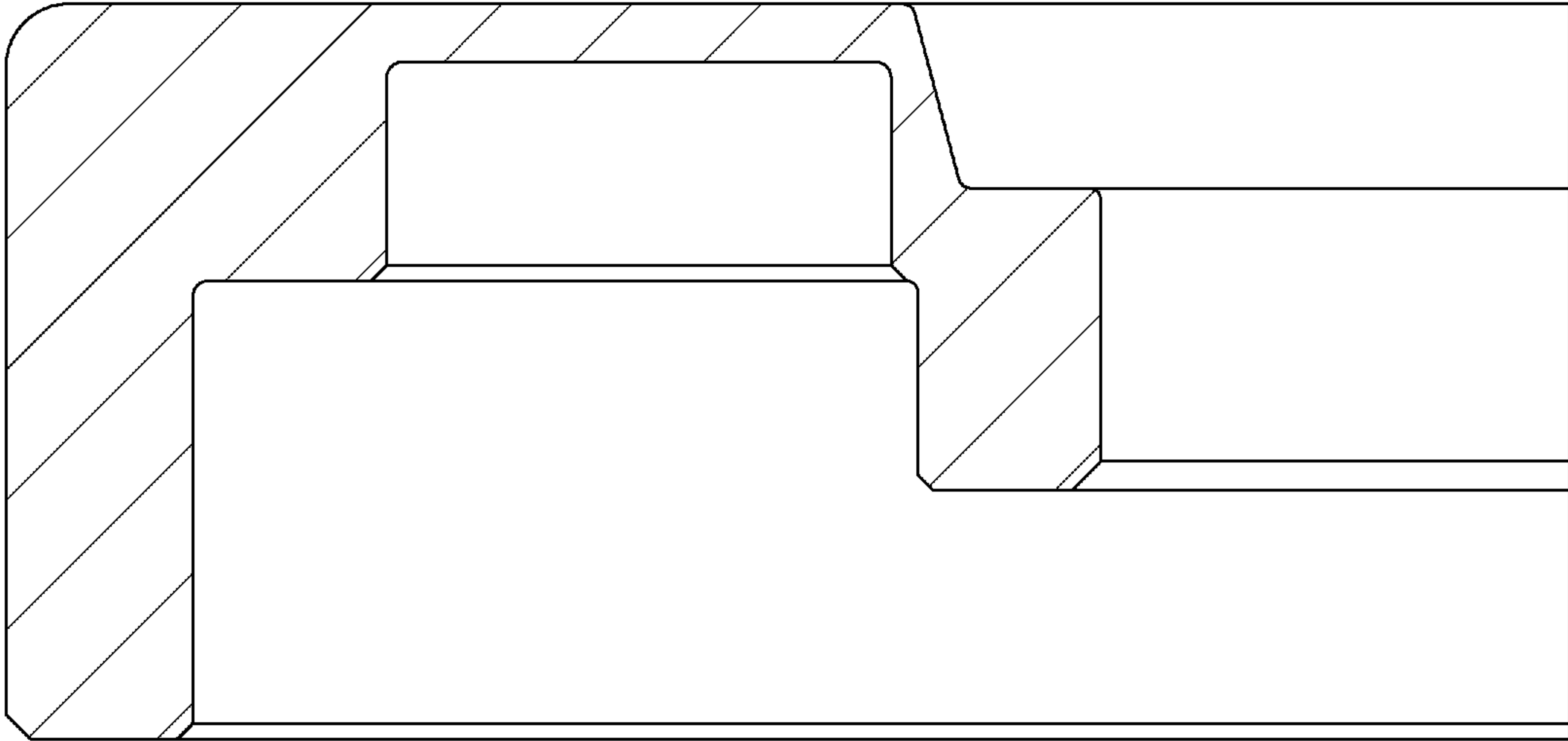
【仰 視 圖】

【左側視圖】

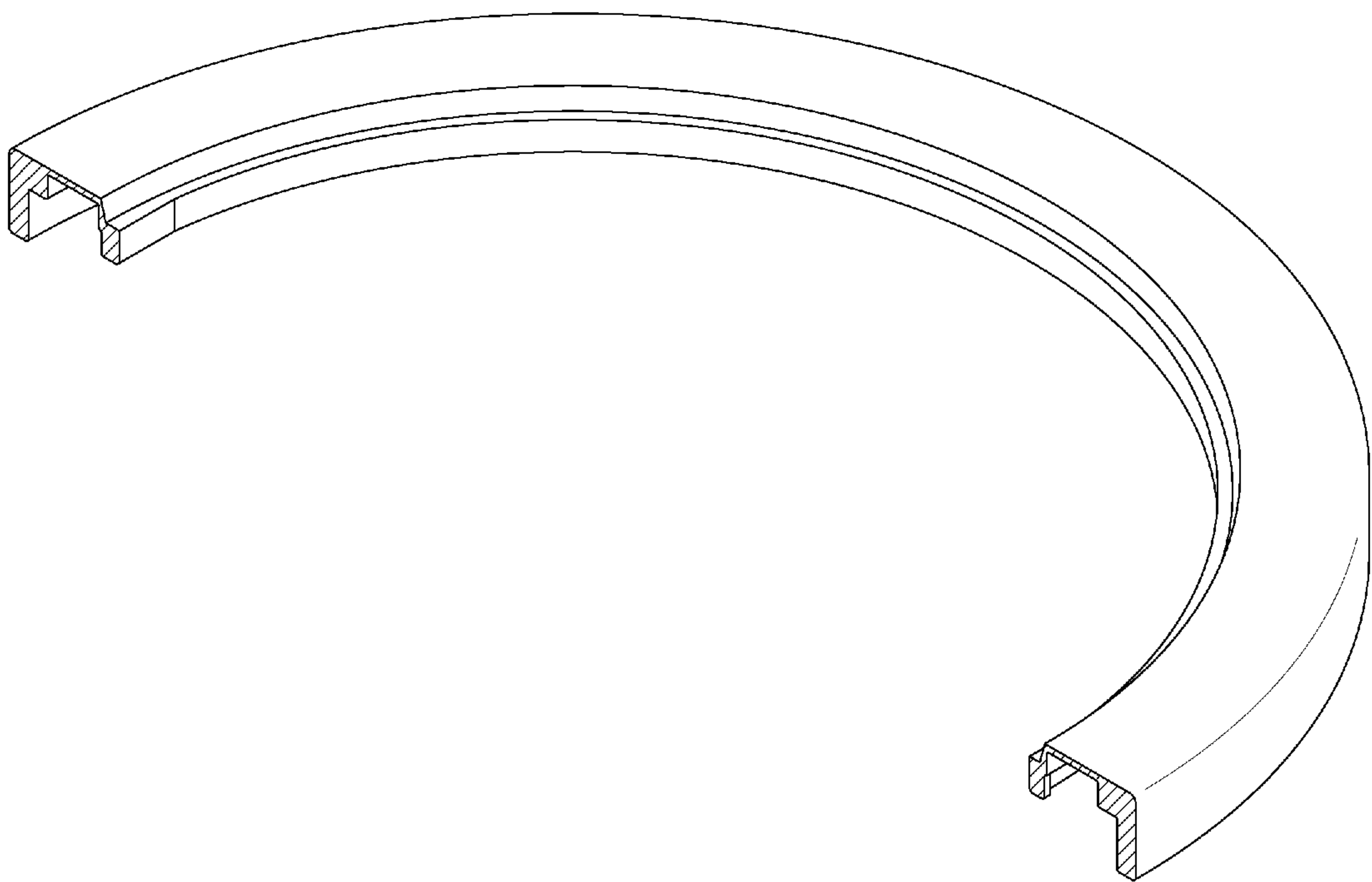
【右側視圖】



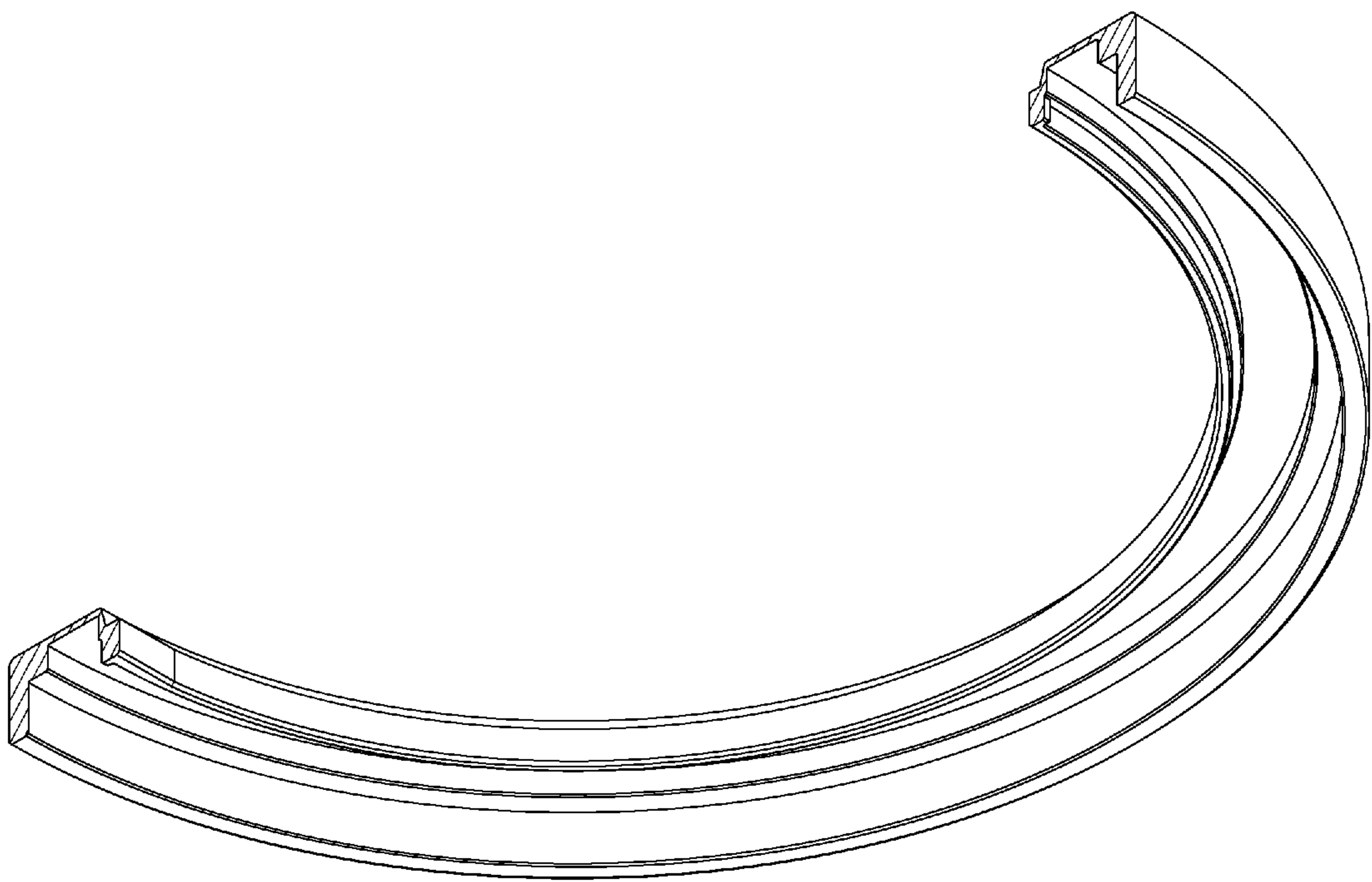
【A-A 剖面圖】



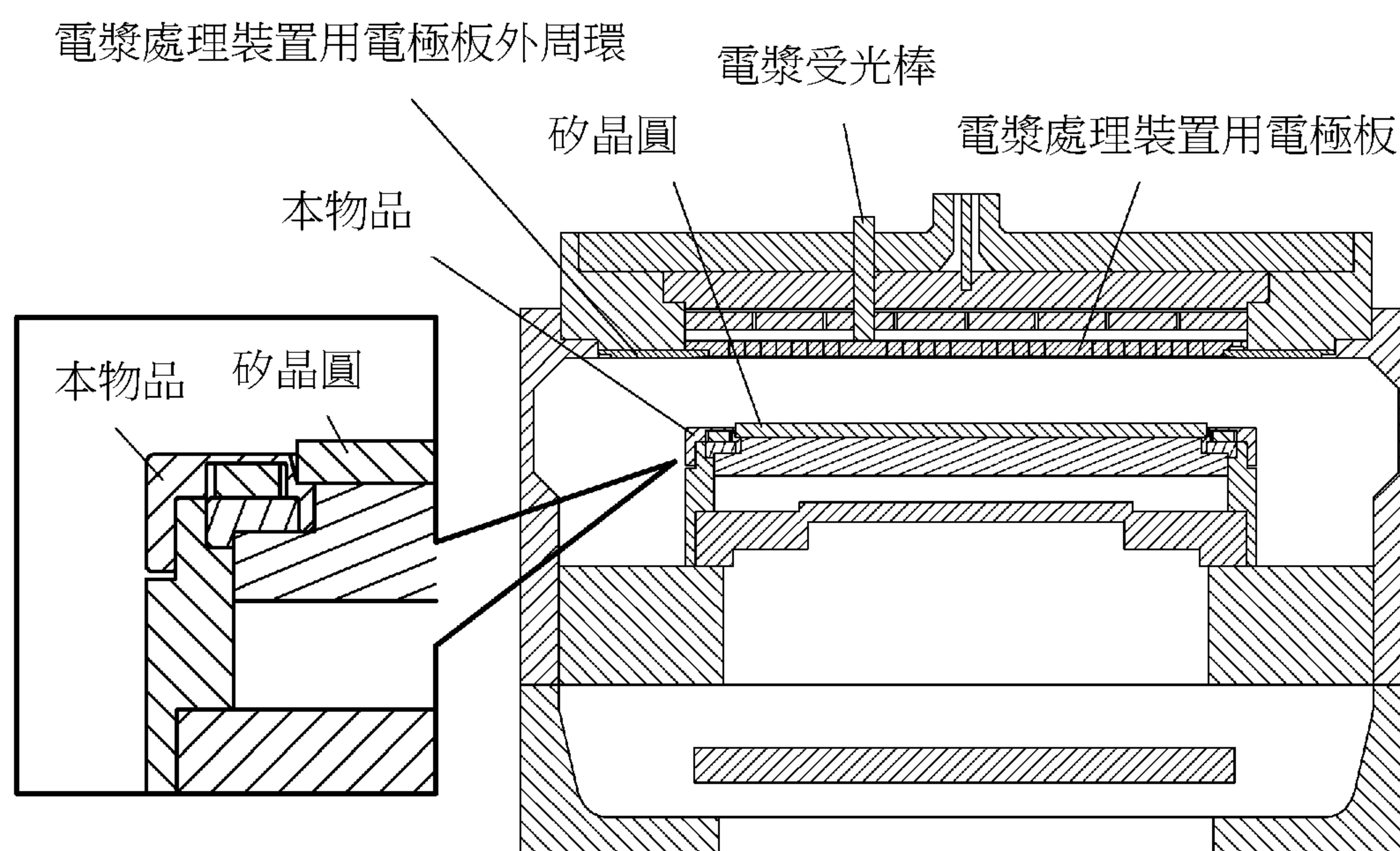
【B-B 部分放大圖】



【A-A線部分立體放大剖面圖1】



【A-A線部分立體放大剖面圖2】



【使用狀態及標示各部名稱之參考圖】